

IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA E INGENIERÍA EN MATERIALES

Cuitláhuac Ver; a 15 de enero del 2018.

Estimado (a) Colega

Manuela Calixto Rodríguez

Agradecemos sinceramente el interés de participar en el **IX Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales (CNCIM)**, es por ello y por este conducto que nos complace informarle que su trabajo:

Síntesis de Películas delgadas de Cu-Sb-S por depósito químico y su tratamiento por plasma para la obtención del compuesto Cu₃SbS₄

Cuyos autores son:

G.C. Santiago, J. Ordaz-Plata, M. Calixto-Rodríguez, Michelle González, Y. Peña-Méndez, P. Altuzar, H. Martínez

Ha sido **ACEPTADO** para su presentación en la modalidad de **Ponencia**.

A nombre del comité organizador del **IX Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales (CNCIM)**, agradecemos su participación y esperamos tener la oportunidad de saludarle oportunamente en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, en el Municipio de Cuitláhuac, Veracruz, del 21 al 23 de marzo del presente año. Así mismo, lo invitamos a realizar su pago antes del 15 de febrero con el fin de registrar la fecha y hora de su participación en la página del evento, www.cncim2018.com y asegurar su lugar en el taller y su Kit de participante, por lo que deberá enviar su Boucher a través del portal electrónico para poder descargar el templete de la revista la cual tiene como fecha límite de envío el 23 de Marzo del 2018.

ATENTAMENTE

Dr. Juan Manuel Padilla Flores

Miembro del Comité Organizador del

IX Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales

Ccp. Archivo